

SO8-FL



Features

- ▶ SOIC 8 ldと同じフットプリントの、薄型、かつ熱特性強化型パッケージ
- ▶ より優れた放熱効率のためのデュアルCuクリップ接続
- ▶ クリップ+ワイヤおよび複数ワイヤーに対応
- ▶ テストとパッキングサービスを備えたターンキー
- ▶ 環境に優しい材料：Pbフリーめっき、ハロゲンフリーモールド樹脂

New Developments

- ▶ より優れた熱性能のための両面露出パッド
- ▶ 細いダイシングラインで薄型ウェハダイシングに対応
- ▶ より大型/より高密度のリードフレームストリップ
- ▶ 環境に配慮したPbフリーはんだペースト

Process Highlights

- ▶ めっき加工なしのベアCuリードフレーム
- ▶ ダイアタッチ：55 μm厚チップピックアップ
- ▶ インターコネクト：より優れた電気性能と熱性能を追求したCuクリップ技術。クリップ+ワイヤおよび複数ワイヤーに対応
- ▶ めっき：100%無光沢Sn
- ▶ マーキング：ペンタイプレーザー

SO8-FL（フラットリード）は薄型の熱特性強化型パッケージであり、標準SOIC 8 ldパッケージと同じフットプリント面積（5 x 6 mm）を維持しながらワット損を47%改善しています。JEDECとJEITAパッケージアウトラインの両方をラインナップしております。

本パッケージは以下の名称でも知られています：

- ▶ SOP-Adv
- ▶ PowerFLAT 5x6
- ▶ TDSO8
- ▶ HVSON
- ▶ JEDEC MO240 AA

Applications

SO8-FLは低オン抵抗と高速スイッチングMOSFET向けに設計され、ミディアムパワーアプリケーションに最適です：

- ▶ バッテリー保護回路
- ▶ ノートPC
- ▶ ポータブル電子機器
- ▶ DC/DCコンバーター

Reliability Qualification

Amkorのデバイスは実績のある信頼性の高い部材で製造されています。

- ▶ 前処理条件（全試験前に実施）：Ta = 85°C/Rh = 85%, 72 hrs with IR reflow, Ta = 265°C, 3X
- ▶ 高温保管（HTS）：Ta = 150°C, 1000 hrs
- ▶ プレッシャークッカー：Ta = 121°C/Rh = 100%/P = 2 atm, 96 hrs
- ▶ 温度サイクル：-65~150°C, 300 cycles

Test Service

Amkorはすべてのパワーディスクリート製品においてフルターンキーを提案いたします。MOSFET、バイポーラトランジスター、IGBT、ダイオードおよびレギュレータIC/インテリジェントパワーデバイスを含む様々なパワーデバイスのテストに対応しています。

- ▶ パワーディスクリートテスト：
 - ▷ DC試験
 - ▷ AC試験（スイッチング試験、容量試験、Rg試験等）
 - ▷ L負荷試験（UIS）
 - ▷ 熱抵抗（ ΔV_{DS} 、 ΔmV など）
- ▶ プログラム作成/コンバージョン
- ▶ 不良解析
- ▶ テスト/ハンドリング技術
- ▶ マーキング、外観検査、テープ&リール 一体機

S08-FL

Standard Materials

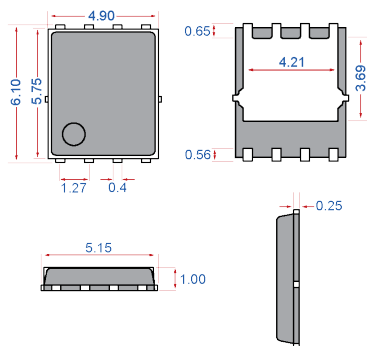
- ▶ リードフレーム：ベアCu
- ▶ ダイアタッチ：はんだペースト (3つのオプション)：
 - ▷ デュアルCuクリップ
 - ▷ 複数Cuワイヤ
 - ▷ Cuクリップ+1ゲートワイヤ
- ▶ モールド樹脂：ハロゲンフリー

Shipping

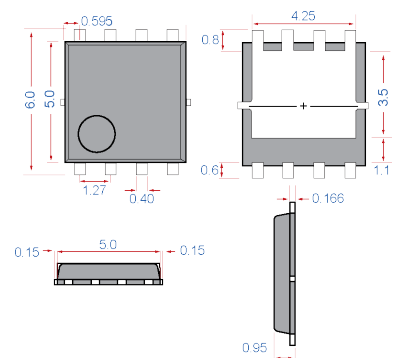
- ▶ テープ&リール
 - ▷ 3000 pcs or 5000 pcs/リール
 - ▷ テープ幅 12 mm
 - ▷ リール Φ = 330 mm
- ▶ バーコードラベル
- ▶ ドロップシッパ

Package Outline Drawing

JEDEC

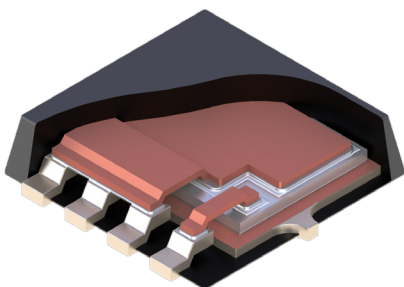


JEITA

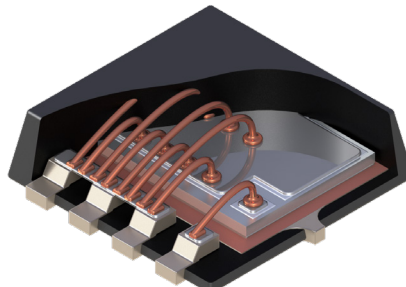


Cross-section

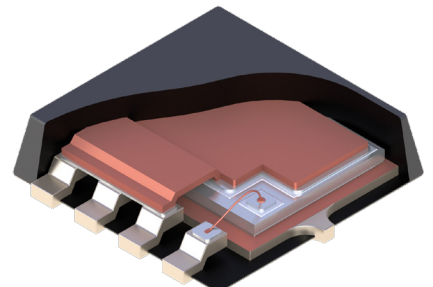
Dual Copper Clip



Multiple Copper Wires



Copper Clip and Wire



詳細についてはamkor.comにアクセス、またはsales@amkor.com までメールをお送りください。



本文中の情報に関して、Amkorは、それが正確であることまたはかかる情報の利用が第三者の知的権利を侵害しないことについて、いかなる保証もいたしません。Amkorは同情報の利用もしくはそれに対する信頼から生じたいかなる性質の損失または損害についても責任を負わないものとし、また本文書によっていかなる特許またはその他のライセンスも許諾しません。本文書は、いかなる形でも販売の標準契約条件の規定を超え、いかなる製品に対しても、Amkorの保証を拡張させ、または変更することはありません。Amkorは通知することなくいつでもその製品および仕様に変更を行う権利を留保します。Amkorの名前とロゴはAmkor Technology, Inc.の登録商標です。記載されている他の全ての商標は、それぞれの会社の財産です。

© 2018 Amkor Technology Incorporated. All Rights Reserved. DS611D-JD Rev Date: 10/18

